

## IPC ERFA-møde, torsdag den 15. juni 2023

Afholdes hos HYTEK

### Dagsorden:

**10:00**      **Velkomst** v/Jens Taudal Andersen, HYTEK

**10:05**      **FLEXXALUMINA® PCBs and FPCs**

v/Enno Henze and Michael Bisges, Plasma Innovations GmbH

A new generation of printed circuit boards replacing copper by aluminum as the conductor tracer material:

- The rationale to replace copper
- Challenges using aluminum
- The FLEXXAL®- process - making aluminum solderable
- FLEXXALUMINA® product portfolio and pilot use cases
- Benefits in electronic manufacturing and end use
- Next steps in aluminum electronics

**11:20**      **Pause 10 min**

**11:30**      **Konnektorer på godt og ondt** v/Poul Juul, HYTEK

- Producent
- Elektriske parametre
- Mekaniske parametre
  - Hustype
  - Termineringer
    - Materiale
    - Overfladefinish
  - Kontakter
    - Materiale
    - Overfladefinish
  - Dimensioner
  - Vægt
  - Tolerancer
- Produktions- og test-tekniske forhold
- Miljømæssige forhold
- Levetid
- Levering
- Pris
- Alternativer
- Typiske fejltyper

**12:00**      **Frokost**

**13:00**      **Fortsat - Konnektorer på godt og ondt** v/Poul Juul, HYTEK

**13:30**      **Pause 15 min**

**13:45**      **Nyt fra IPC** v/Jens Taudal Andersen, HYTEK m.fl.

- Gennemgang af de nyeste udgivne IPC-standarder mv.
- Oplevelser og erfaringer fra IPC APEX EXPO 2023 v/Henrik Blegvad Jensen, Gåsdal Bygningsindustri; Poul Skjold, Danfoss Drives og Allan Nørgaard, VELUX

**Ca. 14:30**      **Eventuelt**

- Forslag til emner på kommende møder